

Disclosure

信息披露 /131

© 2026年8月20日 星期四 上海證券報

(上接 129 页)
本次会计政策的变更是公司根据财政部最新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的相应变更,无需经公司董事会、股东会审议。
特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码: 688778 证券简称: 科思科技 公告编号: 2026-042

深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2026年8月27日(星期四)下午16:00-17:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者请于2026年8月20日(星期四)至2026年8月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(securities@consys.com.cn)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月20日发布2026年半年度报告,为便于广大投资者近距离地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月27日(星期四)下午16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2026年8月27日(星期四)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:沈健先生

董事会秘书:陈晨女士

财务总监:马晓燕女士

独立董事:韩伟先生

(如有特殊情形,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者若可在2026年8月27日(星期四)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者若可在2026年8月20日(星期四)至2026年8月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(securities@consys.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:(0755) 96111131-9858

邮箱:scurities@consys.com.cn

其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码: 688778 证券简称: 科思科技 公告编号: 2026-039

深圳市科思科技股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为履行对投资者为本上市公司发展理念,维护投资者利益,推动提升深圳科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”或“公司”)质量和投资价值,助力信心提振,积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议,公司已于2026年4月10日发布了《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动实施方案暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》,自行动方案发布以来,公司上下凝心聚力,切实履行公司的责任和使命,保障投资者权益,共同促进资本市场平稳健康发展。报告期内,为践行需求拉动,整体经营承压,业务转型升级带来阶段性调整等多重因素影响,公司经营业绩出现明显下滑。盈利水平同比有所回落。公司高度重视当前经营存在的压力与不足,坚持问题导向,深入推进提质增效、风险防控、治理升级等各项工作,持续完善经营管理体系,稳步提升经营发展质量。现将2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告如下:

一、提升经营质量,夯实发展根基

公司聚焦经营质效提升,以主营业务市场为中心,拓展新城市市场,全力推动各项经营举措落地。公司坚持“固本拓新”,持续推出主要产品交付项目,继续巩固主业基本盘。同时积极拓展,加强产品优化,持续推进技术转型升级,围绕战略发展方向,在新市场、新领域持续加大拓展力度。公司积极开拓应用,电力、矿山等行业拓展,持续加大市场推广力度,争取更多民用行业客户订单落地。在海外市场方面,公司积极拓展产品在东、中、亚等地区的推广,已与部分海外客户签署 MOU 协议、NDA 协议。

资金与应收账款管理方面,公司依托全面预算算持续深化业财融合,打通业务端与财务端信息壁垒,强化数据分析对经营决策的支撑作用,优化资源配置效率。公司高度重视应收账款清收管理,持续推进账款回收工作。报告期内,公司收到回款(含票据)14,508.15万元,截至目前,期后回款(含票据)2,367.06万元,相关工作按计划有序推进。

募投项目管理方面,报告期内,公司持续推进募投项目建设,研发技术中心建设项目稳步推进,将原计划购置房屋的实施方式调整为租赁房屋,部分研发子项目已实现结项并形成销售收入,新增科思科技西安分公司为实施主体并完成募集资金专户开立,进一步提升募集资金使用效率,加快实施进程。电子信息装备生产基地建设项目的桩基工程已如完工,项目施工各项工作有序推进。经审慎论证,公司新

取的核心骨干人员(不包括公司董事和高级管理人员)。

修订后:

本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任核心骨干人员(本激励计划所称核心骨干人员,系指公司主要董事和高级管理人员以外,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员)。

(二)对“二、激励对象的范围”修订如下:

修订前:

本激励计划激励对象总人数为318人,占2026年12月31日公司员工总数的比例为8.01%,主要为未参与公司2019年员工持股方案的核心人员。鉴于公司主要董事和高级管理人员已参与公司2019年员工持股方案及公司首发员工战略配售,本次激励计划激励对象不包含公司董事和高级管理人员。

修订后:

本激励计划激励对象总人数为313人,占2026年12月31日公司员工总数的比例为7.88%,主要为未参与公司2019年员工持股方案的核心人员。鉴于公司主要董事和高级管理人员已参与公司2019年员工持股方案及公司首发员工战略配售,本次激励计划激励对象不包含公司董事和高级管理人员,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员。

(三)对“第五章 本激励计划所涉及的股票来源、数量及分配”修订如下:

修订前:

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,910,218股,约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.58%,本激励计划不设置预留授予权益。

修订后:

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,870,716股,约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.57%,本激励计划不设置预留授予权益。

(二)对“三、激励对象及授出权益分配情况”修订如下:

修订前:

本激励计划激励对象总人数为318人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任的核心骨干人员。本激励计划激励对象前不包括公司董事和高级管理人员。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	获授限制性股票数量(万股)	占本激励计划公告时公司股本总额的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
核心骨干人员(共313人)	2,870,716	100%	0.58%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2、在限制性股票授予前,激励对象因个人原因自愿放弃或因其个人原因需调低获授权益的,由董事会审议并相应调整,可以将该激励对象放弃或调减的权益份额在公司其他激励对象之间进行分配和调减或直接注销,但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。

3、上述分配情况出现总人数与各项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

修订后:

本激励计划激励对象总人数为313人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任的核心骨干人员。本激励计划激励对象不包含公司董事和高级管理人员,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占本激励计划公告时公司股本总额的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
王亚娟	董事会秘书	2,870,716	100.00%	0.58%
核心骨干人员(共312人)		2,870,716	100.00%	0.57%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额10%。

2、在限制性股票授予前,激励对象因个人原因自愿放弃或因其个人原因需调低获授权益的,由董事会审议并相应调整,可以将该激励对象放弃或调减的权益份额在公司其他激励对象之间进行分配和调减或直接注销,但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。

3、上述分配情况出现总人数与各项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、本激励计划激励对象总人数为313人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任的核心骨干人员。本激励计划激励对象不包含公司董事和高级管理人员,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员。

(二)对“第四章 激励对象的确定依据和范围”修订如下:

修订前:

本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任核心骨干人员(本激励计划所称核心骨干人员,系指公司主要董事和高级管理人员以外,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员)。

(三)对“第五章 本激励计划所涉及的股票来源、数量及分配”修订如下:

修订前:

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,910,218股,约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.58%,本激励计划不设置预留授予权益。

修订后:

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,870,716股,约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.57%,本激励计划不设置预留授予权益。

(二)对“三、激励对象及授出权益分配情况”修订如下:

修订前:

本激励计划激励对象总人数为318人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任的核心骨干人员。本激励计划激励对象前不包括公司董事和高级管理人员。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占本激励计划公告时公司股本总额的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
王亚娟	董事会秘书	2,870,716	100.00%	0.58%
核心骨干人员(共312人)		2,870,716	100.00%	0.57%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额10%。

2、在限制性股票授予前,激励对象因个人原因自愿放弃或因其个人原因需调低获授权益的,由董事会审议并相应调整,可以将该激励对象放弃或调减的权益份额在公司其他激励对象之间进行分配和调减或直接注销,但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。

3、上述分配情况出现总人数与各项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、本激励计划激励对象总人数为313人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任的核心骨干人员。本激励计划激励对象不包含公司董事和高级管理人员,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员。

(二)对“第四章 激励对象的确定依据和范围”修订如下:

修订前:

本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任核心骨干人员(本激励计划所称核心骨干人员,系指公司主要董事和高级管理人员以外,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员)。

(三)对“第五章 本激励计划所涉及的股票来源、数量及分配”修订如下:

修订前:

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,910,218股,约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.58%,本激励计划不设置预留授予权益。

修订后:

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,870,716股,约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.57%,本激励计划不设置预留授予权益。

(二)对“三、激励对象及授出权益分配情况”修订如下:

修订前:

本激励计划激励对象总人数为318人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任的核心骨干人员。本激励计划激励对象前不包括公司董事和高级管理人员。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占本激励计划公告时公司股本总额的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
王亚娟	董事会秘书	2,870,716	100.00%	0.58%
核心骨干人员(共312人)		2,870,716	100.00%	0.57%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额10%。

2、在限制性股票授予前,激励对象因个人原因自愿放弃或因其个人原因需调低获授权益的,由董事会审议并相应调整,可以将该激励对象放弃或调减的权益份额在公司其他激励对象之间进行分配和调减或直接注销,但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。

3、上述分配情况出现总人数与各项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、本激励计划激励对象总人数为313人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任的核心骨干人员。本激励计划激励对象不包含公司董事和高级管理人员,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员。

(二)对“第四章 激励对象的确定依据和范围”修订如下:

修订前:

本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任核心骨干人员(本激励计划所称核心骨干人员,系指公司主要董事和高级管理人员以外,现除岗位变动担任过公司董事会秘书的王亚娟外,不包括其他董事及高级管理人员)。

增投股控公司江苏苏电车载系统有限公司为项目实施主体,增加专用车辆改装业务相关内容并将项目达到预定可使用状态的期限延长至2027年12月,公司将持续推进项目建设,争取早日使项目达到预定可使用状态。

二、发挥创新引领作用,激活增长动能

2026年上半年,公司持续创新驱动发展,维持高强度的研发投入力度,保障技术迭代与新产品研制工作有序推进。上半年研发投入13,605.74万元,同比增长37.8%,研发投入占营业收入比例为13.72%。公司不断优化调整研发投入队伍结构,完善研发人员引进、培养及优化迭代机制,增加研发效率,为芯片、智能模组、无人装备等核心业务的技术攻关筑牢人才根基。

公司始终以创新为驱动,紧密围绕客户实际应用场景开展深度需求挖掘,依托严谨的市场研判与需求分析,行业前瞻布局,协同创新新赛道,聚焦关键核心技术开展迭代攻关与成果转化。公司前瞻性布局智能化、无人化方向,形成“芯片—模组—整机—系统”的完整产业链能力。公司在全产业链上持续投入研发资源,开展研发工作,在自主研发芯片、全场景模组、无人装备和智能产品方面取得研发进展。公司持续深耕芯片自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片处理能力已完全满足全部需求,同步开发具有前瞻性的配套软件,该芯片应用于智能无人装备产品,各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后道设计与验证工作,芯片设计实现低成本、低功耗方向,力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争优势。公司自研第一代智能收发芯片已完成功能、性能全项测试,现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线通信等多元应用场景,能够与公司自主研发无线通信芯片协同匹配,构建具备市场竞争力的一体化解决方案。公司已布局并开展第二代智能收发芯片研发工作,目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作,该芯片相比第一代在信号带宽和频宽范围等方面都有较大提升,能够适应更广泛领域的应用。智能模组业务上,公司与华为昇腾智能模组产品自主研发工作,新一代智能无人装备芯片产品已进入商品化量产阶段。新一代智能无人装备芯片